

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年8月31日(31.08.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/163086 A1

(51) 国際特許分類:

C08L 101/00 (2006.01) C08L 35/00 (2006.01)
B32B 15/082 (2006.01) C08L 53/02 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
C08L 9/00 (2006.01)

Tokyo (JP). 竹口 彩香(TAKEGUCHI Ayaka);
〒1058518 東京都港区芝大門一丁目 1 3 - 9
株式会社レゾナック内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人大谷特許事務所(OHTANI
PATENT OFFICE); 〒1050001 東京都港区虎
ノ門三丁目 2 5 番 2 号 虎ノ門 E S
ビル7階 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/006630

(22) 国際出願日: 2023年2月24日(24.02.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-030093 2022年2月28日(28.02.2022) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック (RESONAC
CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港
区芝大門一丁目 1 3 番 9 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 佐藤 直義(SATO Naoyoshi); 〒1058518
東京都港区芝大門一丁目 1 3 - 9 株式
会社レゾナック内 Tokyo (JP). 谷川 隆雄
(TANIGAWA Takao); 〒1058518 東京都港区
芝大門一丁目 1 3 - 9 株式会社レゾナッ
ク内 Tokyo (JP). 福井 将人(FUKUI Masato);
〒1058518 東京都港区芝大門一丁目 1 3 - 9
株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 明比 龍
史(AKEBI Ryuji); 〒1058518 東京都港区芝大
門一丁目 1 3 - 9 株式会社レゾナック内

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,
KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,

(54) Title: RESIN COMPOSITION, PREPREG, LAMINATED BOARD, RESIN FILM, PRINTED WIRING BOARD,
AND SEMICONDUCTOR PACKAGE

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、プリプレグ、積層板、樹脂フィルム、プリント配線板及び半導体パッケージ

(57) Abstract: The present invention relates to: a resin composition containing (A) a thermosetting resin and (B) a copoly-
mer resin containing structural units derived from an aromatic vinyl compound and structural units derived from an unsat-
urated aliphatic hydrocarbon, the component (B) being such that the content value for the structural units derived from an
aromatic vinyl compound (B1) is 25-60 mass% and the content value, in terms of mass, of the structural units derived from
an aromatic vinyl compound (B2) is less than that for the component (B1), and the component (B1) content of the resin
composition being greater, in terms of mass, than the component (B2) content of the resin composition; and a prepreg, a
laminated board, a resin film, a printed wiring board, and a semiconductor package in which said resin composition is used.

(57) 要約: (A) 熱硬化性樹脂と、(B) 芳香族ビニル化合物由来の構造単位及び不飽和脂肪族炭
化水素由来の構造単位を含む共重合樹脂と、を含有する樹脂組成物であり、前記 (B) 成分は、
(B 1) 芳香族ビニル化合物由来の構造単位の含有量が 25 ~ 60 質量%であるものと、(B 2)
芳香族ビニル化合物由来の構造単位の質量基準の含有量が、前記 (B 1) 成分よりも少ないもの
と、を含有し、前記樹脂組成物中における前記 (B 1) 成分の含有量が、前記樹脂組成物中におけ
る前記 (B 2) 成分の含有量よりも質量基準で多い、樹脂組成物、該樹脂組成物を用いたプリプレ
グ、積層板、樹脂フィルム、プリント配線板及び半導体パッケージに関する。

[続葉有]

WO 2023/163086 A1

RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）